

2024-2030年中国芯片设计 行业前景展望与发展趋势研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国芯片设计行业前景展望与发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/414164.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

芯片（Chip）是半导体元件产品的统称，也是集成电路的载体。芯片是集成电路经过“设计、制造、封装、测试”后形成的可立即使用的独立整体，集成电路必须依托芯片来发挥他的作用。

我国集成电路设计行业增速迅猛，在集成电路行业中的比重不断提升。2021年，我国集成电路设计行业销售规模达4519亿元，同比增长19.6%。集成电路布图设计方面，2022年上半年，我国集成电路布图设计登记申请7661件，发证5233件。截至2022年6月底，我国集成电路布图设计登记申请累计7.4万件，发证5.7万件。

芯片设计行业已经成为国内半导体产业中最具发展活力的领域之一，近年来，中国芯片设计产业在提升自给率、政策支持、规格升级与创新应用等要素的驱动下，保持高速成长的趋势。2021年国内芯片设计企业的数量增长到了2810家，较2020年的2218家，增长了26.7%（592家）。

2020年8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，加速推动产业集聚发展，推动产业对标国际领先技术。2021年3月12日，两会受权发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到，要制定实施战略性科学计划和科学工程，瞄准前沿领域。其中特别提到，在集成电路领域，需关注集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发以及细分领域特色工艺突破等。这表明，国家将集成电路的发展放在纲领性文件中。2021年3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》，明确了对五类情形免征进口关税，将于2020年7月27日至2030年12月31日实施，意味着《通知》涉及到的商品将享受免征进口关税10年的利好。2021年4月22日，工信部、国家发改委、财政部和国家税务局发布2021年第9号公告，明确了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）第二条中所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。公告自2020年1月1日起实施。自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。在政策利好、需求剧增的情况下，中国芯片行业将进入快速发展期，产业链各个环节的业绩有望爆发。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片设计行业前景展望与发展趋势研究报告》共十一章。首先介绍了芯片设计行业的基本概念及行业发展环境，接着分析了中国芯片产业及芯片设计行业总体发展状况。然后分别对芯片设计行业细分产品、芯片设计工具、产业园区进行了详尽的透析，并对国内外芯片设计行业重点企业经营状况做了分析。最后，报告对芯片设计行业进行了投资价值评估并对行业未来发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、中国海关、中国半导体行业协会、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对芯片设计行业有个系统深入的了解、或者想投资芯片设计相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录：

第一章 芯片设计行业相关概述

1.1 芯片的概念和分类

1.1.1 芯片基本概念

1.1.2 相关概念区分

1.1.3 芯片主要分类

1.2 芯片产业链结构

1.2.1 芯片产业链结构

1.2.2 芯片生产流程图

1.2.3 产业链核心环节

1.3 芯片设计行业概述

1.3.1 芯片设计行业简介

1.3.2 芯片设计基本分类

1.3.3 芯片设计产业图谱

第二章 2021-2023年中国芯片设计行业发展环境

2.1 经济环境

2.1.1 国内宏观经济概况

2.1.2 工业经济运行情况

2.1.3 固定资产投资状况

2.1.4 国内宏观经济展望

2.2 政策环境

2.2.1 智能制造发展战略

2.2.2 中国制造支持政策

2.2.3 集成电路相关政策

2.2.4 地方芯片产业政策

2.2.5 产业投资基金支持

2.3 社会环境

2.3.1 移动网络运行状况

2.3.2 电子信息产业增速

2.3.3 电子信息设备规模

2.3.4 研发经费投入增长

2.4 技术环境

2.4.1 芯片技术专利申请

2.4.2 芯片技术创新升级

2.4.3 芯片技术发展方向

第三章 2021-2023年中国芯片产业发展分析

3.1 中国芯片产业发展综述

3.1.1 产业基本特征

3.1.2 产业发展背景

3.1.3 产业发展意义

3.1.4 产业发展现状

3.2 2021-2023年中国芯片市场运行状况

3.2.1 产业销售规模

3.2.2 市场结构分析

3.2.3 产品产量规模

3.2.4 企业发展状况

3.2.5 区域发展格局

3.3 2021-2023年中国芯片细分市场发展情况

3.3.1 5G芯片

3.3.2 AI芯片

3.3.3 生物芯片

3.3.4 车载芯片

3.3.5 电源管理芯片

3.4 2021-2023年中国集成电路进出口数据分析

3.4.1 进出口总量数据分析

3.4.2 主要贸易国进出口情况分析

- 3.4.3 主要省市进出口情况分析
- 3.5 2021-2023年中国芯片国产化进程分析
 - 3.5.1 芯片国产化发展背景
 - 3.5.2 核心芯片的自给率低
 - 3.5.3 芯片国产化进展分析
 - 3.5.4 芯片国产化存在问题
 - 3.5.5 芯片国产化未来展望
- 3.6 中国芯片产业发展困境分析
 - 3.6.1 市场垄断困境
 - 3.6.2 贸易依赖非对称性
 - 3.6.3 技术短板问题
 - 3.6.4 人才短缺问题
- 3.7 中国芯片产业应对策略分析
 - 3.7.1 总体发展策略
 - 3.7.2 掌握核心技术
 - 3.7.3 引进高端人才
 - 3.7.4 优化产业链结构
 - 3.7.5 增强企业竞争力

第四章 2021-2023年芯片设计行业发展全面分析

- 4.1 2021-2023年全球芯片设计行业发展综述
 - 4.1.1 市场发展规模
 - 4.1.2 区域市场格局
 - 4.1.3 企业排名分析
- 4.2 2021-2023年中国芯片设计行业运行状况
 - 4.2.1 行业发展历程
 - 4.2.2 市场发展规模
 - 4.2.3 专利申请情况
 - 4.2.4 资本市场表现
 - 4.2.5 细分市场发展
- 4.3 新冠肺炎疫情对中国芯片设计行业的影响分析
 - 4.3.1 对芯片设计企业的短期影响

- 4.3.2 对芯片产业链的影响
- 4.3.3 芯片设计企业应对措施
- 4.4 中国芯片设计市场发展格局分析
 - 4.4.1 企业竞争格局
 - 4.4.2 企业发展状况
 - 4.4.3 企业数量规模
 - 4.4.4 企业布局动态
 - 4.4.5 区域分布格局
 - 4.4.6 产品应用分布
- 4.5 芯片设计行业上市公司财务状况分析
 - 4.5.1 上市公司规模
 - 4.5.2 上市公司分布
 - 4.5.3 经营状况分析
 - 4.5.4 盈利能力分析
 - 4.5.5 营运能力分析
 - 4.5.6 成长能力分析
 - 4.5.7 现金流量分析
- 4.6 芯片设计具体流程剖析
 - 4.6.1 规格制定
 - 4.6.2 设计细节
 - 4.6.3 逻辑设计
 - 4.6.4 电路布局
 - 4.6.5 光罩制作
- 4.7 芯片设计行业发展存在的问题和对策
 - 4.7.1 人才短缺问题
 - 4.7.2 设计能力不足
 - 4.7.3 资本研发投入不足
 - 4.7.4 费用支出过多
 - 4.7.5 产业发展建议
 - 4.7.6 产业创新策略

第五章 2021-2023年中国芯片设计行业细分产品发展分析

5.1 逻辑IC产品设计发展状况

5.1.1 CPU

5.1.2 GPU

5.1.3 MCU

5.1.4 ASIC

5.1.5 FPGA

5.1.6 DSP

5.2 存储IC产品设计发展状况

5.2.1 DRAM

5.2.2 NAND Flash

5.2.3 NOR Flash

5.3 模拟IC产品设计发展状况

5.3.1 射频器件

5.3.2 模数/数模转换器

5.3.3 电源管理产品

第六章 中国芯片设计工具——EDA（电子设计自动化）软件市场发展状况

6.1 EDA软件基本概述

6.1.1 EDA软件基本概念

6.1.2 EDA软件的重要性

6.1.3 EDA软件主要类型

6.1.4 EDA软件设计过程

6.1.5 EDA软件设计步骤

6.2 全球芯片设计EDA软件行业发展分析

6.2.1 市场规模状况

6.2.2 细分市场结构

6.2.3 区域分布情况

6.2.4 主流产品平台

6.2.5 竞争梯队分析

6.2.6 市场集中度

6.3 中国芯片设计EDA软件行业发展分析

6.3.1 产业链结构分析

- 6.3.2 行业发展规模
- 6.3.3 国内竞争格局
- 6.3.4 行业市场集中度
- 6.3.5 发展前景及趋势
- 6.3.6 行业发展问题
- 6.3.7 行业发展对策
- 6.4 EDA技术及工具发展沿革及作用
 - 6.4.1 GDS&GDS II
 - 6.4.2 SPICE
 - 6.4.3 半导体器件模型 (SPICE Model)
 - 6.4.4 硬件描述语言 (HDL)
 - 6.4.5 静态时序分析

第七章 中国芯片设计产业园区建设分析

- 7.1 深圳集成电路设计应用产业园
 - 7.1.1 园区发展环境
 - 7.1.2 园区基本简介
 - 7.1.3 园区战略定位
 - 7.1.4 园区服务内容
- 7.2 北京中关村集成电路设计园
 - 7.2.1 园区发展环境
 - 7.2.2 园区基本简介
 - 7.2.3 园区战略定位
 - 7.2.4 园区建设特色
 - 7.2.5 园区发展现状
 - 7.2.6 园区发展成果
 - 7.2.7 疫情影响分析
 - 7.2.8 园区发展规划
- 7.3 上海集成电路设计产业园
 - 7.3.1 园区发展环境
 - 7.3.2 园区基本简介
 - 7.3.3 园区投资优势

- 7.3.4 园区发展状况
- 7.3.5 园区项目建设
- 7.4 无锡国家集成电路设计产业园
 - 7.4.1 园区发展环境
 - 7.4.2 园区基本简介
 - 7.4.3 园区发展状况
 - 7.4.4 园区发展成果
 - 7.4.5 园区区位优势
- 7.5 杭州集成电路设计产业园
 - 7.5.1 园区发展环境
 - 7.5.2 园区基本简介
 - 7.5.3 园区签约项目
 - 7.5.4 园区发展规划

第八章 2021-2023年国外芯片设计重点企业经营状况

- 8.1 博通 (Broadcom Limited)
 - 8.1.1 企业发展概况
 - 8.1.2 企业经营状况
 - 8.1.3 芯片业务运营
 - 8.1.4 产品研发动态
- 8.2 高通 (QUALCOMM, Inc.)
 - 8.2.1 企业发展概况
 - 8.2.2 企业经营状况
 - 8.2.3 企业业务布局
 - 8.2.4 产品研发动态
 - 8.2.5 企业发展战略
- 8.3 英伟达 (NVIDIA)
 - 8.3.1 企业发展概况
 - 8.3.2 企业经营状况
 - 8.3.3 企业竞争优势
 - 8.3.4 产品研发动态
- 8.4 超微 (AMD)

- 8.4.1 企业发展概况
- 8.4.2 企业经营状况
- 8.4.3 芯片业务状况
- 8.4.4 产品研发动态
- 8.4.5 企业战略合作
- 8.5 赛灵思 (Xilinx)
- 8.5.1 企业发展概况
- 8.5.2 企业经营状况
- 8.5.3 企业业务分布
- 8.5.4 产品研发动态

第九章 2020-2023年国内芯片设计重点企业经营状况

- 9.1 联发科
 - 9.1.1 企业发展概况
 - 9.1.2 企业经营状况
 - 9.1.3 企业发展实力
 - 9.1.4 重点产品介绍
- 9.2 华为海思
 - 9.2.1 企业发展概况
 - 9.2.2 企业经营状况
 - 9.2.3 业务发展布局
 - 9.2.4 主要产品范围
- 9.3 紫光展锐
 - 9.3.1 企业发展概况
 - 9.3.2 企业经营状况
 - 9.3.3 企业发展实力
 - 9.3.4 企业发展布局
 - 9.3.5 企业资本动态
- 9.4 中兴微电子
 - 9.4.1 企业发展概况
 - 9.4.2 企业经营状况
 - 9.4.3 专利研发实力

- 9.4.4 资本结构变化
- 9.4.5 核心技术进展
- 9.5 华大半导体
 - 9.5.1 企业发展概况
 - 9.5.2 企业发展实力
 - 9.5.3 重点产品介绍
 - 9.5.4 产品研发动态
 - 9.5.5 企业合作动态
- 9.6 深圳市汇顶科技股份有限公司
 - 9.6.1 企业发展概况
 - 9.6.2 业务发展布局
 - 9.6.3 经营效益分析
 - 9.6.4 业务经营分析
 - 9.6.5 财务状况分析
 - 9.6.6 核心竞争力分析
 - 9.6.7 公司发展战略
 - 9.6.8 未来前景展望
- 9.7 北京兆易创新科技股份有限公司
 - 9.7.1 企业发展概况
 - 9.7.2 业务发展布局
 - 9.7.3 经营效益分析
 - 9.7.4 业务经营分析
 - 9.7.5 财务状况分析
 - 9.7.6 核心竞争力分析
 - 9.7.7 公司发展战略
 - 9.7.8 未来前景展望

第十章 芯片设计行业投资价值综合分析

- 10.1 集成电路产业投资价值评估及投资建议
 - 10.1.1 投资价值综合评估
 - 10.1.2 市场机会矩阵分析
 - 10.1.3 产业进入时机分析

- 10.1.4 产业投资风险剖析
- 10.1.5 产业投资策略建议
- 10.2 芯片设计行业进入壁垒评估
 - 10.2.1 行业竞争壁垒
 - 10.2.2 行业技术壁垒
 - 10.2.3 行业资金壁垒
- 10.3 芯片设计行业投资状况分析
 - 10.3.1 产业投资规模
 - 10.3.2 产业融资轮次
 - 10.3.3 产业投资热点
 - 10.3.4 企业募资规模
 - 10.3.5 产业募资动态

第十一章 2024-2030年芯片设计行业发展趋势和前景预测分析

- 11.1 中国芯片市场发展机遇分析
 - 11.1.1 产业发展机遇分析
 - 11.1.2 新兴产业带来机遇
 - 11.1.3 产业未来发展趋势
- 11.2 中国芯片设计行业发展前景展望
 - 11.2.1 芯片研发前景
 - 11.2.2 市场需求增长
 - 11.2.3 行业发展前景
- 11.3 2024-2030年中国芯片设计行业预测分析
 - 11.3.1 2024-2030年中国芯片设计行业影响因素分析
 - 11.3.2 2024-2030年中国IC设计行业销售规模预测

图表目录

- 图表1 芯片产品分类
- 图表2 集成电路产业链及部分企业
- 图表3 芯片生产历程
- 图表4 芯片设计产业图谱
- 图表5 2020年GDP最终核实数与初步核算数对比

- 图表6 2021年GDP初步核算数据
- 图表7 2022年我国GDP初步核算数据
- 图表8 2016-2020年全部工业增加值及其增长速度
- 图表9 2020-2021年规模以上工业增加值同比增长速度
- 图表10 2021年规模以上工业生产主要数据
- 图表11 2021-2022年规模以上工业增加值同比增长速度
- 图表12 2022年规模以上工业生产主要数据
- 图表13 2019-2020年固定资产投资（不含农户）同比增速
- 图表14 2020年固定资产投资（不含农户）主要数据
- 图表15 2020-2021年全国固定资产投资（不含农户）同比增速
- 图表16 2021年固定资产投资（不含农户）主要数据
- 图表17 2021-2022年全国固定资产投资（不含农户）同比增速
- 图表18 2022年固定资产投资（不含农户）主要数据
- 图表19 《中国制造2025》半导体产业政策目标与政策支持
- 图表20 2015-2030年IC产业政策目标与发展重点
- 图表21 2018-2022年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（一）
- 图表22 2018-2022年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（二）
- 图表23 2018-2022年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（三）
- 图表24 2018-2022年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（四）
- 图表25 中国各省市集成电路行业政策汇总及解读（一）
- 图表26 中国各省市集成电路行业政策汇总及解读（二）
- 图表27 中国各省市集成电路行业政策汇总及解读（三）
- 图表28 中国各省市集成电路行业政策汇总及解读（四）
- 图表29 中国各省市集成电路行业政策汇总及解读（五）
- 图表30 中国各省市集成电路行业政策汇总及解读（六）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/414164.html>